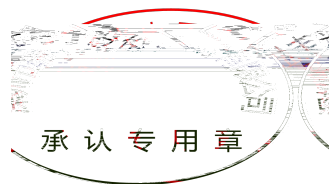


# PECIFICA ION 产品 书

REFOND P/N 产品型号  
RF-E30AG-IRB-FS

R&D 发  
 Ma P d c 产供



C

1. D c 产品介

1.1 G a D c 产品

1.2 F a 产品

1.3 A ca 产品

1.4 Pac a D

1.5 P d c Pa a 产品参

1.6 T ca ca c a ac c c 典型光

2. Pac a 产品包

2.1 Pac a S c ca 包

2.1.1 Ca Ta D

2.1.2 R D 卷

2.1.3 Lab F S c ca

2.3 Ca db a d B 包

2.4 R ab T l A d C d 信 及 件

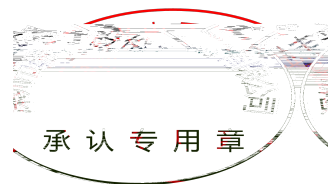
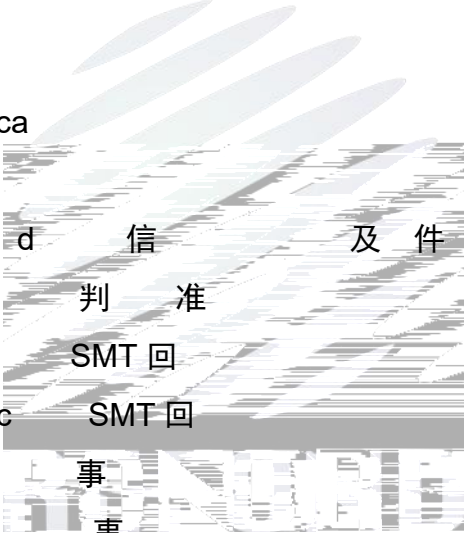
2.5 C a F J d Da a 判 准

3. SMT R S d l c SMT 回

3.1 SMT R S d l c SMT 回

4. Ha d P ca 产品使 事

4.1 Ha d P ca 产品使 事



## 1. D 产品介绍

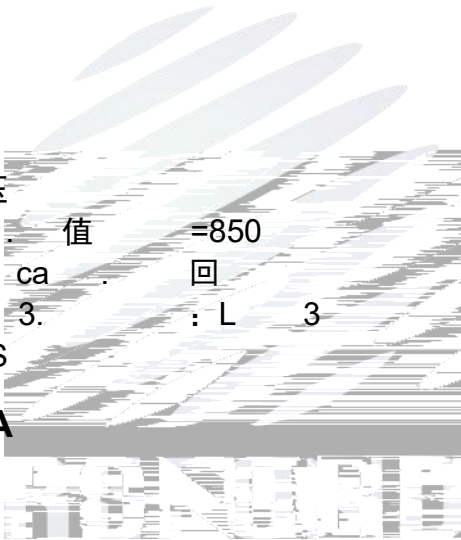
### 1.1 G D 产品A



T d c EMC ac a , a a ab . a b d a ca  
c a d .S ( ): 3.00 X3.00 X2.10 .

产品 EMC , 可 . 于各 和传 器 产品中。  
产品 : 3.00X3.00X2.10

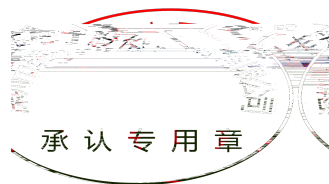
### 1.2 F 产品



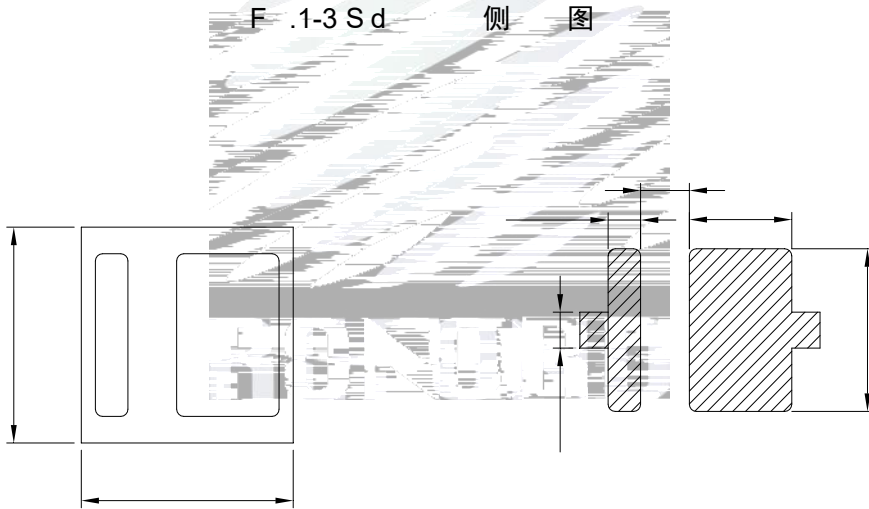
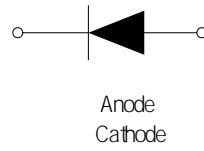
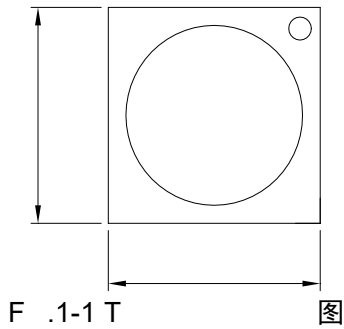
L a d a . 低 压  
P a a =850 . 值 =850  
Pb- d a ca . 回  
M :L 3. : L 3  
R HS c a . 合R HS

### 1.3 A 产品 A

S a c .  
l a dl a ca a . 外  
Mac . 器



1.4 P D

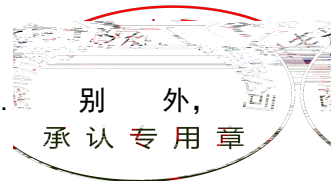


N 备 :

- 1. A d a .
- 2. A d a c a ±0.2

单位为

d. 别 外, 公 为±0.2



# 1.5 P P 产品参

Tab 1-1 E c ca / O ca C a ac c a T =25 C 与光

I	S b 号	T C d 件	Va			U 单位
			M . ( 值)	T (典型值)	Ma . ( 值)	
R C ( )	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =5V	---	---	10	A
F a d V a ( 向 压)	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =1000 A	1.4	1.7	2.0	V
P a Wa ( 值 )	λ	I <sub>F</sub> =1000 A	830	850	---	
S c Rad a Ba d d 半		I <sub>F</sub> =1000 A	---	37	---	
T a ada 功		I <sub>F</sub> =1000 A	450	710	1120	W
V A (发光 )	2 1/2	I <sub>F</sub> =1000 A	---	90	---	d
T a R a c . ( )	R <sub>THJ-S</sub>	I <sub>F</sub> =1000 A	---	16	---	/W



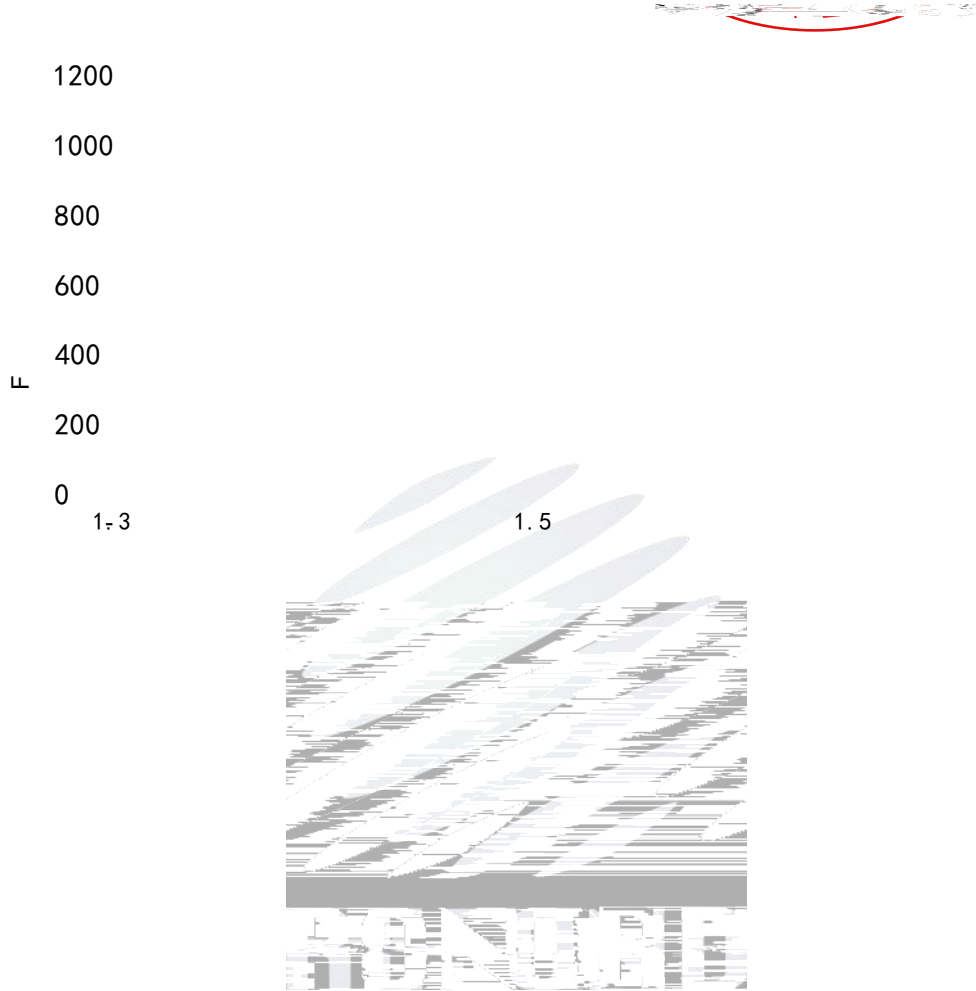
Tab 1-2 Ab Ma Ra a T =25 C 值

Pa a (参)	S b (号)	Ra (值)	U (单位)
P D a (功)	P <sub>D</sub>	1.7	W
F a d C (向)	I <sub>F</sub>	1000	A
R V a (反向压)	V <sub>R</sub>	5	V
E c a c D c a (HBM) ( )	E <sub>SD</sub>	2000	V
O a T a (作)	T <sub>OPR</sub>	-40 +85	
S a T a (储)	T <sub>STG</sub>	-40 +100	
J c T a ( )	T <sub>J</sub>	115	

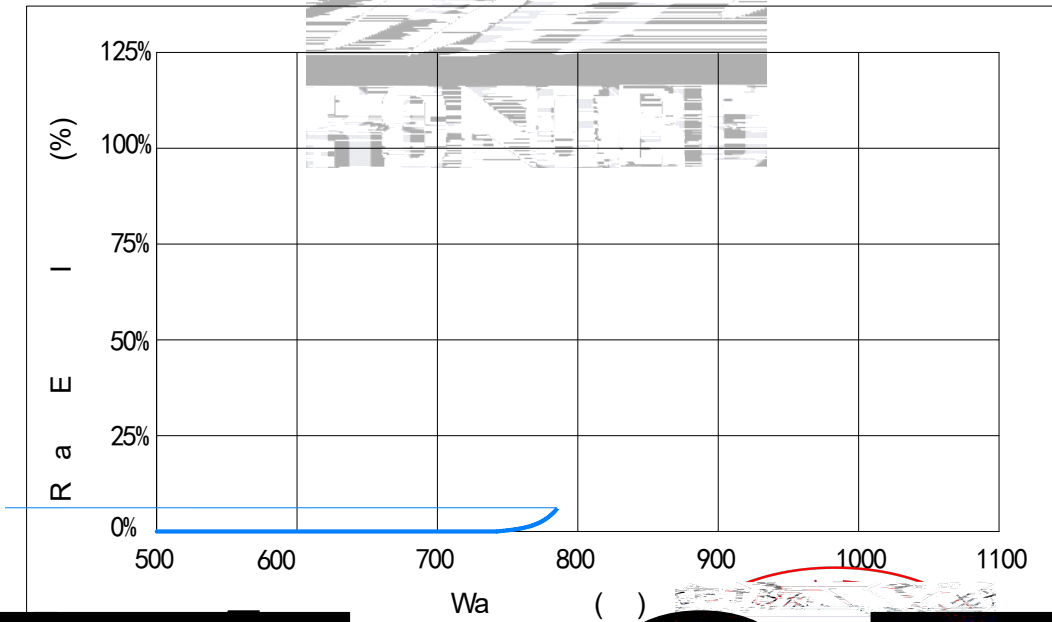
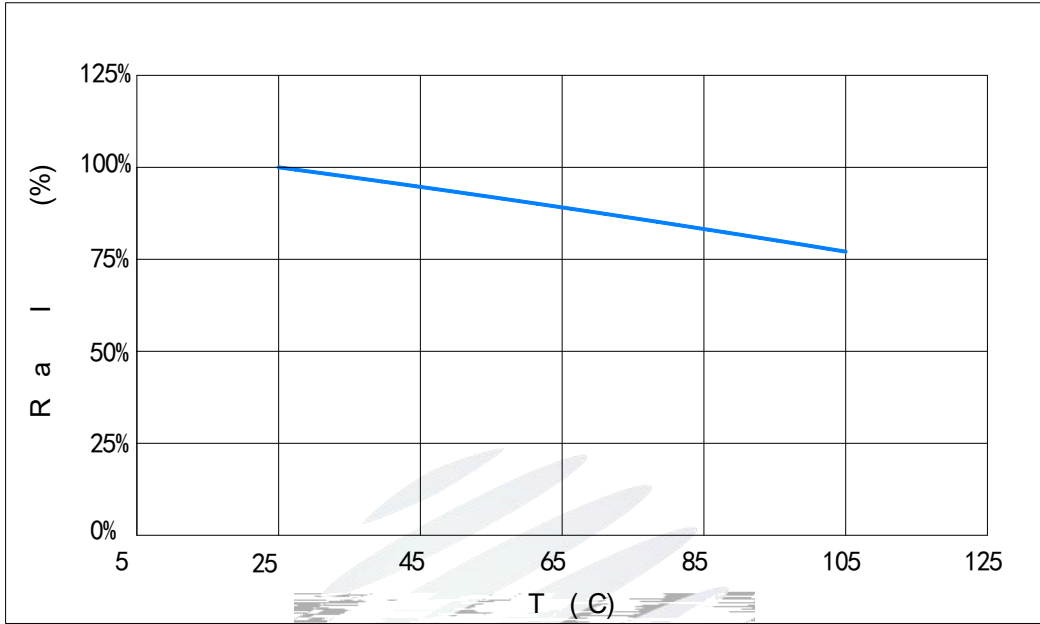
N 备 :

- 1.1/10 D c c , 0.1 d . 0.1ms, 占 1/10.
- 2.T ab a d a a a a a c a c 0.1V. 以上 压 ±0.1V.
- 3.T a c a T a a d a / R a d a l : 10%. 功 / 公 : ±10%.
- 4.Ca b a a d a d c d a b a a d c . 使 功 不 值。
- 5.A a a d d a d a d d R d . 基于 丰 准 台。
- 6.W LED a a a c d b d c d a a a c a a c a d c d a a . LED使 件 , 不 值。
- 7.ESD d 90% a 2000V ESD (HBM). ESD c d d c a d d d . 90% LED 人体 ESD2000V , 在 作 。



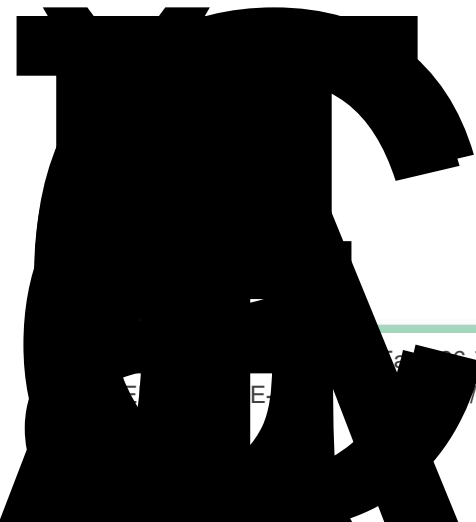
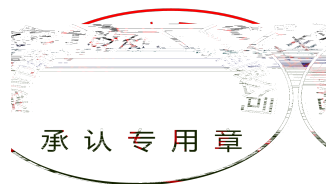
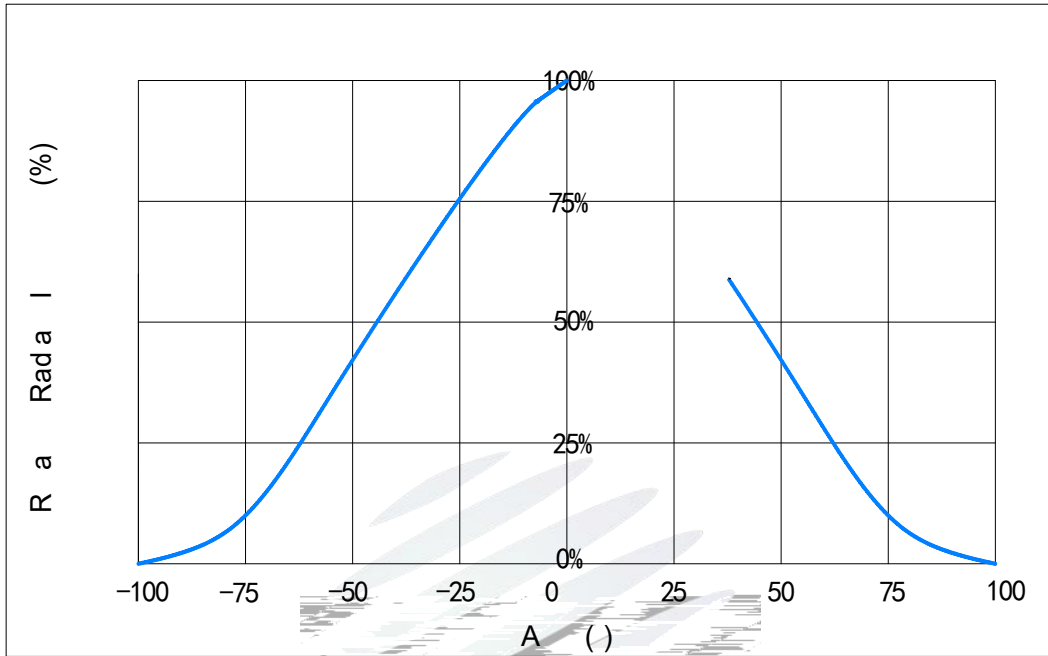


※



承认行用章





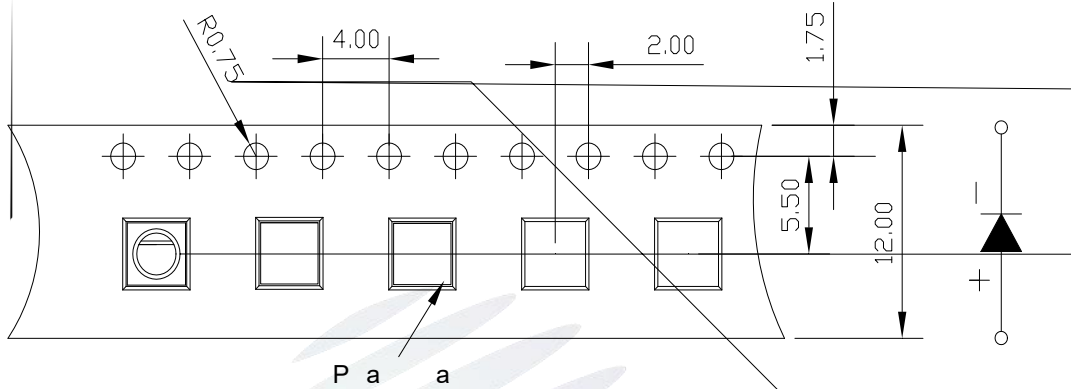
2. P 产品包

2.1 P

包

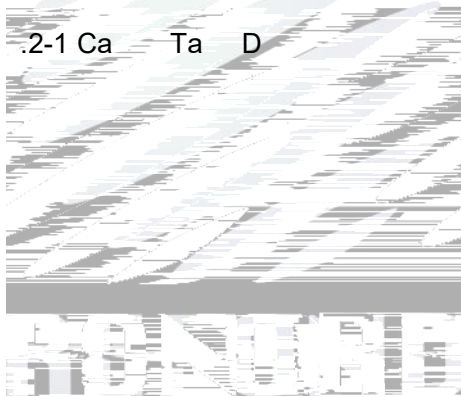
Pac a :3000 c / .包 卷 3000pcs。

2.1.1 Ca Ta D



F .2-1 Ca Ta D

2.1.2 R D 卷



Tab 2-1 D



A	12.7 0.3
B	330.2 2
C	79.5 1
D	14.3 0.2

F .2-2R D 卷

N 备 :

T a c d 0.1 .U : 0.1 , .

2.1.3 Lab F S c ca

PAR NO.	
PEC NO.	
LO NO.	
BIN CODE	
F	LP
	Q :
	DA E:

Tab 2-2 Lab F S c ca

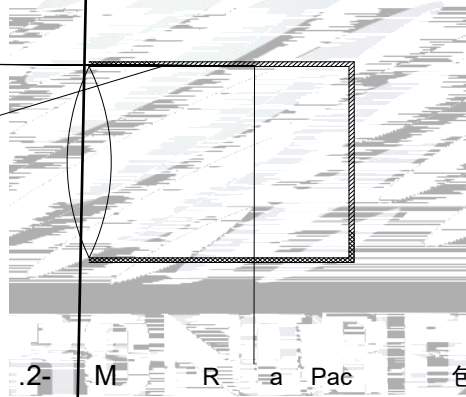
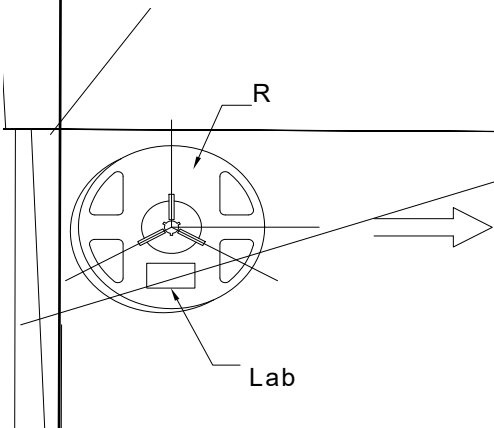
PART NO	Pa N b	品名
SPEC NO	S c N b	
LOT NO	L N b	号
BIN CODE	B C d	区
	T a a d a	光功
WLP	P a W a	值
V <sub>F</sub>	F a d V a	向压
QTY	Pac Q a	
DATE	Mad Da	产

F 2-3 Lab F S c ca

2.2 M R a Pac 包

包

M Ba Ba



F .2- M R a Pac 包

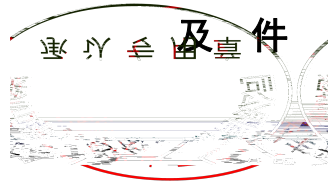
2.3 Ca db a d B 包

F .2-5 Ca db a d B 包

2.4 R

I A A C

信



Tab 2-3 R ab T I A



## 2.5 C F J D 判 准

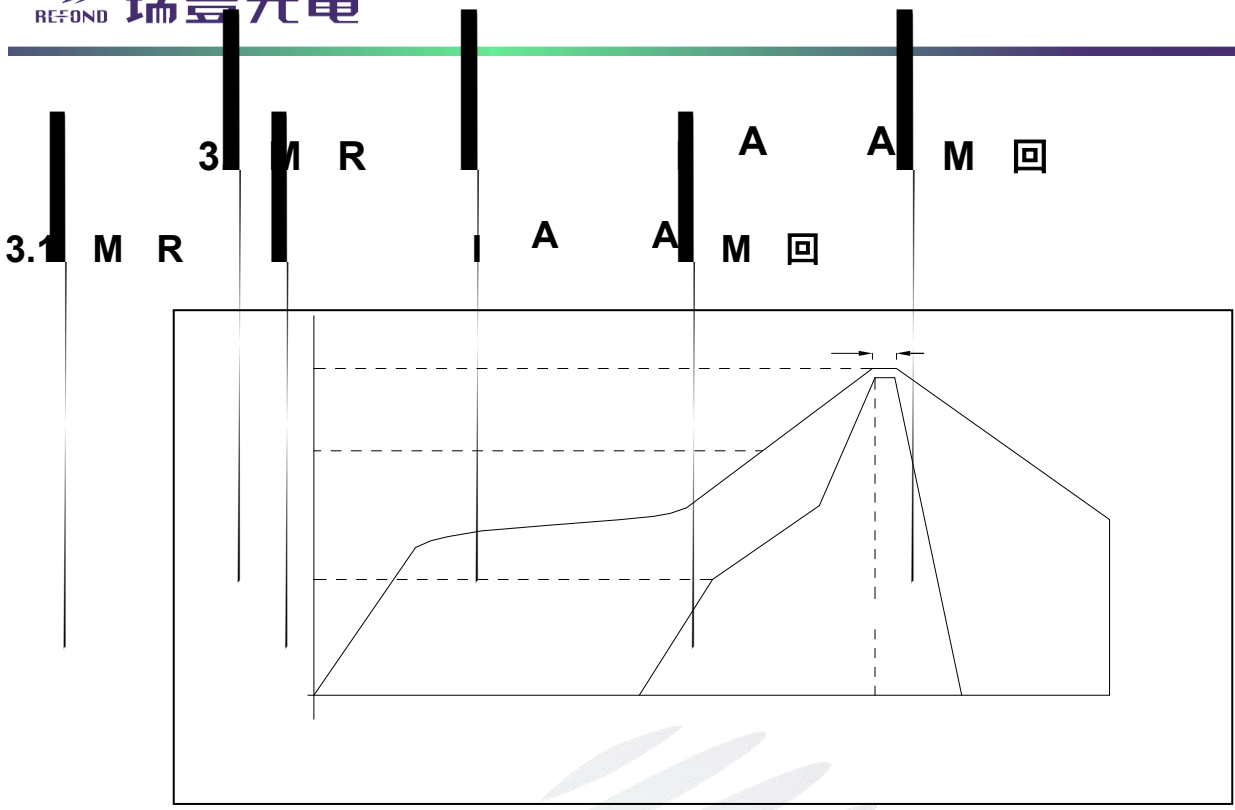
Tab C aF J d Da a 判 准

T I	S b 号	T C d 件	C aF J d 判 准	
			M .	Ma .
F a d V a 向 压	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =1000 A	-	U.S.L*) 1.1
R C 反向	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 5V	-	U.S.L*) 2.0
T a a d a 功		I <sub>F</sub> =1000 A	L.S.L*) 0.7	-

N 备 :

- 1.U.S.L: U a d a d 上 L.S.L: L a d a d 下
- 2.T a b a b b a d c a a / LED R d' a a , a b a a d d a d a c d . c a LED a d a a c c , d a c d a a a c c a c , a d b , a d a a d . 以上可 基于 丰 台单 / LED 在 件 下 。 LED 于串、 , 估 、 压分 、 。
- 3.T c c a a d a a a d c a c a a c c a d c c a c d d c . l d c a a d a a a c . 以上 仅为产品 典型值, 只作为参 , 不作为任何 件及 保 。

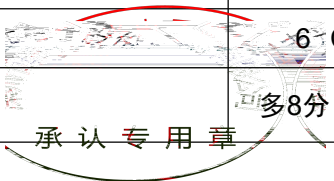




F .3-1 SMT R S d l c SMT 回

Tab 3-1 Pa a 参

A a a d 均升 (T a T <sub>P</sub> )	3 C/ Ma 3 C/
P a : a : 低 (T )	150 C
P a :Ma a : (T a )	200 C
P a :T : (T T a )	60 - 120 60 -120
T d a a a : a : (T <sub>L</sub> )	217 C
T d a a a :T T : (L)	多60 Ma 60
P a /Ca ca a : 值 / 分 (T <sub>P</sub> )	260 C
T ca ca a a 值分 : ( )	多10 Ma 10
H d 5 ° C ac a a a (T <sub>P</sub> ) 与 值 (T <sub>P</sub> ) 5 C 以内 保	多30 Ma 30
C d	6 C/ Ma 6 C/
N d d 25 C T 25 C 升 值	多8分 Ma 8



備 注 :

(1) 回流焊時，LED 不可以兩面同時回流，LED 可於吸熱。

(2) 焊接時，LED 不在受壓體。

### 3.1.1 注意事項

(1) 焊接溫度，不可超過 300°C，不可超過 3 秒。

(2) 回流焊時，LED 只可一面。

### 3.1.2 維修

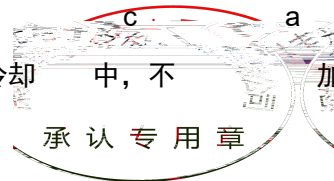
維修時，LED 不可用烙鐵直接加熱，應先將 LED 吸出，再進行維修。若 LED 吸出後，發現 LED 有損壞，應先檢查 LED 是否受壓，若受壓，應先解除壓力，再進行維修。若 LED 有損壞，應先檢查 LED 是否受壓，若受壓，應先解除壓力，再進行維修。

### 3.1.3 注意事項

(1) 回流焊時，LED 不可兩面同時回流，LED 可於吸熱。回流焊時，LED 不可兩面同時回流，LED 可於吸熱。回流焊時，LED 不可兩面同時回流，LED 可於吸熱。

(2) 回流焊時，LED 不可兩面同時回流，LED 可於吸熱。回流焊時，LED 不可兩面同時回流，LED 可於吸熱。

(3) 回流焊時，LED 不可兩面同時回流，LED 可於吸熱。回流焊時，LED 不可兩面同時回流，LED 可於吸熱。



## 4. H P 产品使用事

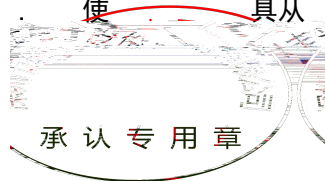
### 4.1 H P 产品使用事

(1) LED a a a .T d d a a a d a a a d .LED 作 境及与 LED 中 元 及化合 份不可 100PPM. 只 一个 , 不作任何品 保。

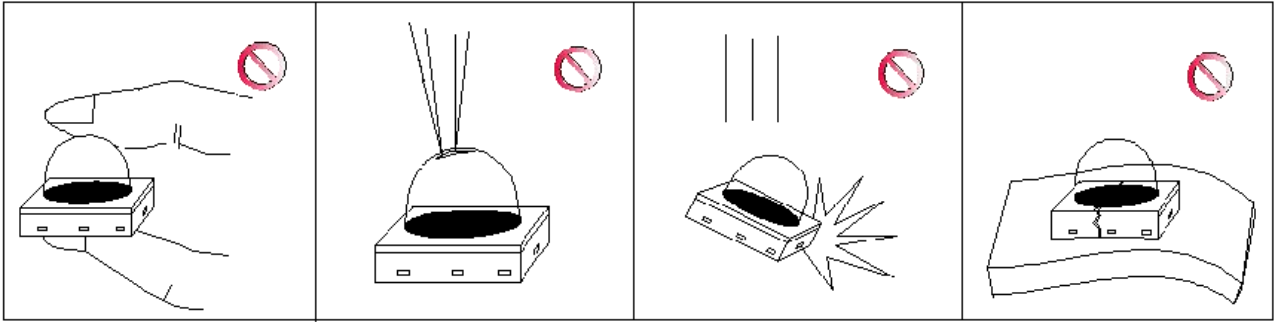
(2) l d - a a a d LED, c a ca a c LED, c B d b a 900PPM, c C d b a 900PPM, a c B a d C a a a a ca d c d b a 1500PPM. T d d a a a d a a a d . 为了 外 入 LED 内 以 LED 伤, 处 境及 件 , 单一 元 含 于 900PPM, 单一 元 含 于 900PPM, 元 与 元 含 于 1500PPM. 只 一个 , 不作任何品 保。

(3) VOC (V a a c c d) d a a d c c ca a c ca a LED a d d c d a a d c .T ca b a ca .K d a a c d b d c c ca .R d a d a a a c ca a a a a b d a c d a a a d a c d c a c ab .T c a b ,R d c d a a c ca a d a a b d c c a ca a d c a a d d b d. A ac LED , d ad a a a c a . 件中 发 会 到 LED 内 , 在 产 光 及 件 下, 会 LED 变 , 严 光 , 前了 件 免产 些 。 丰反 使 任何 LED 器件 可 , 不 些 了 仅仅 。 和 使 境, 丰 和 。 在 LED 候, 不 使 产 发 体 剂。

(4) Ha d c a d ac b c a a ; d d c c Ha d c ac , a da a a c c 使 具从 侧 取, 不可 压 体 , 可 会 坏内 。







F 4-1

(5) LED 产品，在安装和使用过程中，应避免以下行为：  
 1. 禁止将 LED 产品直接插入墙壁插座。  
 2. 禁止 LED 产品长时间连续工作，导致产品过热。  
 3. 禁止 LED 产品被尖锐物体撞击。  
 4. 禁止 LED 产品放置在承重能力不足或正在变形的表面上。  
 此外，LED 产品在启动和关闭时，应避免电压的剧烈波动。LED 产品的工作电压应与产品规格一致，否则会导致 LED 产品损坏。LED 产品在启动时，应避免电压的突然升高，否则会导致 LED 产品损坏。LED 产品在关闭时，应避免电压的突然降低，否则会导致 LED 产品损坏。LED 产品在启动和关闭时，应避免电压的剧烈波动。LED 产品在启动时，应避免电压的突然升高，否则会导致 LED 产品损坏。LED 产品在关闭时，应避免电压的突然降低，否则会导致 LED 产品损坏。

(6) LED 产品在安装和使用过程中，应注意以下事项：  
 1. LED 产品应安装在通风良好的地方，避免长时间连续工作。  
 2. LED 产品应避免在高温、高湿、高尘等恶劣环境下使用。  
 3. LED 产品应避免在易燃易爆场所使用。  
 4. LED 产品应避免在强电磁干扰环境下使用。  
 5. LED 产品应避免在腐蚀性气体或液体环境中使用。  
 6. LED 产品应避免在震动较大的地方使用。  
 7. LED 产品应避免在潮湿的地方使用。  
 8. LED 产品应避免在阳光直射的地方使用。  
 9. LED 产品应避免在强风的地方使用。  
 10. LED 产品应避免在强磁场的地方使用。

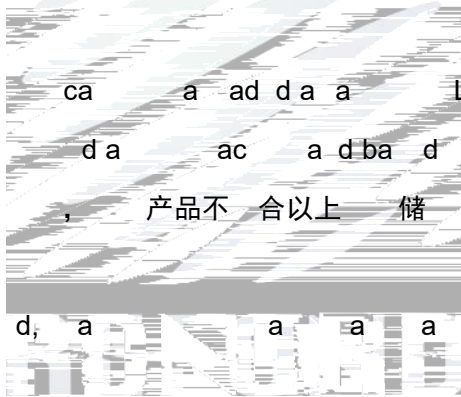
(7) LED 产品在安装和使用过程中，应注意以下事项：  
 1. LED 产品应安装在通风良好的地方，避免长时间连续工作。  
 2. LED 产品应避免在高温、高湿、高尘等恶劣环境下使用。  
 3. LED 产品应避免在易燃易爆场所使用。  
 4. LED 产品应避免在强电磁干扰环境下使用。  
 5. LED 产品应避免在腐蚀性气体或液体环境中使用。  
 6. LED 产品应避免在震动较大的地方使用。  
 7. LED 产品应避免在潮湿的地方使用。  
 8. LED 产品应避免在阳光直射的地方使用。  
 9. LED 产品应避免在强风的地方使用。  
 10. LED 产品应避免在强磁场的地方使用。  
 11. LED 产品应避免在强酸、强碱等腐蚀性物质附近使用。  
 12. LED 产品应避免在强氧化剂附近使用。  
 13. LED 产品应避免在强还原剂附近使用。  
 14. LED 产品应避免在强还原剂附近使用。  
 15. LED 产品应避免在强还原剂附近使用。



Tab 4-1 S a 儲

C d		T a	H d	T
S a	B O A Ba 包前	≤30°C	≤75%	W 1 Y a F Da — 內
	A O A Ba 包后	≤30°C	≤60%	168 168
Ba		60±5°C	-	≥24 于24

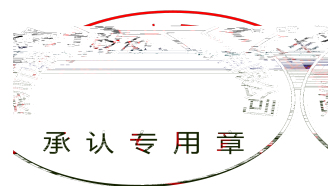
(8) I ab b a a ca a ad da a LED a c d d a  
 ba a db da ac a dba d c d 60 5  
 ab 24 . 剂包 , 产品不 合以上 儲 件, 包后 , 件:  
 60±5°C, 于24 .



I ac a a c da a d, a a a a . 包 ,  
 售人员协助处 .

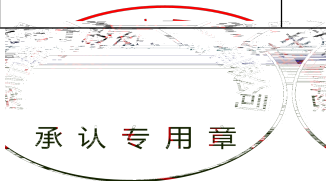
(9) S a S d a d c ; LED a E c -S a c D c a (ESD) a d E c ca  
 O S (EOS). 像其他 半 体 器件一 , LED 击 , 做 .

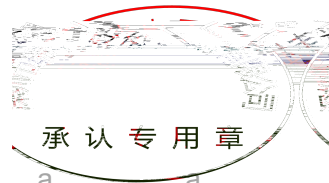
(10) O a , a a a .  
 其 事 参 丰 关 .



### V H /修 历史

Da	R 修	V	V	R a 备
2021-08-09		E/0		





D ca  
 T c ca b E a d C a d  
 产品 书以中 书写, 冲 以中 为准。